

2024年9月9日

各位



【出展のお知らせ】第1回[九州]半導体産業展

当社は「第1回[九州]半導体産業展」に出展いたします。

この機会に是非、当社ブースにお立ち寄りください。



会 期 : 2024年9月25日(水)～9月26日(木)

開場時間 : 10:00～17:00

会 場 : マリンメッセ福岡 B館

当社ブース : 3-12

問い合わせ先 : (株)南陽 産機事業本部 ASS部 [TEL:092-473-7711](tel:092-473-7711)

【展示内容】 前工程から後工程までの製造フローごとのパネル展示及びご紹介

〔ゾーン①〕

前工程：製造装置（露光、リフトオフ装置、コーター）

〔ゾーン②〕

前工程：検査装置（ウェハー貼合せ検査、ウェハー検査機、X線検査機、バンプ界面検査機）

〔ゾーン③〕

後工程：製造装置（リング～リング移載装置、リング～テープ/トレイ移載装置）

〔ゾーン④〕

後工程：検査装置（ダイシング後のウェハー検査機、パッケージ外観検査機）

〔ゾーン⑤〕

後工程：ワイヤボンド工程（クロスワイヤ外観検査、ボンド接合界面レーザー検査機）

〔ゾーン⑥〕

工場内IoT（人・物の所在管理システム、AIによる装置稼働モニタリング・復旧支援）

〔ゾーン⑦〕

工場内自動化（接合箇所の水漏れコーティング&抜け防止補強、次世代AMR、新しい照明ソリューション）

【主な商品のご紹介】

〔世界初〕後付け可能装置用 RPA「AI バーチャル（仮想）オペレーター」 E-box+E-Mon システム

対象とする装置のモニター画面から必要情報を判断し、検査・エラー解除・装置の画面操作を AI ソフトが実施



<実績用途例>

ワイヤボンダー、ダイボンダー、ダイサー、ウェハー検査機

1. 装置で流れる製品のセットアップ
2. 検査レシピまたは設定のセットアップ
3. 装置で発生するソフトウェアジャムからの復旧
4. 照明のキャリブレーション
5. フォーカスのキャリブレーション
6. X軸Y軸のアライメント用キャリブレーション

<イメージ図>

ダイサーのエラー自動復旧
画像位置ずれ調整等



ワイヤボンダーのエラー自動解除&レシピ作成支援



第1回
[九州] 半導体産業展

2024年9月25日・26日 マリンメッセ福岡

来場者募集中!!
来場登録はQRコードまたはURLから



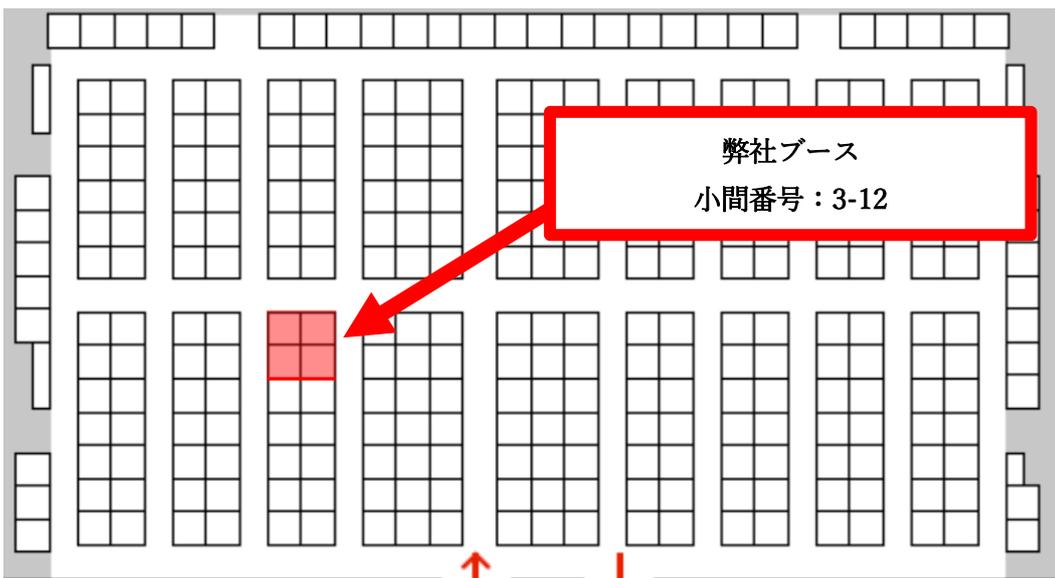
【来場登録 URL】

<https://innovent02.eventos.tokyo/web/portal/730/event/9643/users/register>



Fのりば時刻表
(BRT、88番ともにマリンメッセへ参ります)

行先	中央埠頭	
	呉服町・蔵本 国際会議場前 (快速)	国際会議場前 マリンメッセ前 (普通)
行先番号	BRT (内回り)	88
7時	45	1 14 24 41 47
8時	0 15 30 45	1 3 11 21 31 46 47
9時	0 15 30 45	7 26 34 36
10時	0 15 30 45	31 51
11時	0 15 30 45	31
12時	0 15 30 45	1 11 31 51
13時	0 15 30 45	31
14時	0 15 30 45	11 31
15時	0 15 30 45	16 31 36 56
16時	0 15 30 45	16 31 36 42 56



以上